

Hirata

平田機工株式会社

証券コード：6258 / 2025年2月

決算説明資料

2024年度(2025年3月期)
第3四半期

目 次

- I. 2024年度 第3四半期業績（連結）
- II. 2024年度 通期業績予想（連結）
- III. 株主還元等について
- IV. トピックス
- V. 参考資料

会社概要

会 社 名	平田機工株式会社 (英文表記:HIRATA Corporation)
所 在 地	熊本県熊本市北区植木町一木111番地
代表者名	代表取締役社長執行役員 平田 雄一郎
設 立	1951年12月29日
資 本 金	2,633 百万円
事業内容	各種生産システム、産業用ロボットおよび物流関連機器等の製造ならびに販売
上場市場	東京証券取引所 プライム市場（証券コード 6258）
従 業 員	連結 2,413名 単体 1,529名 ※2024年12月31日現在
事 業 所	国内7拠点(熊本県4拠点、栃木県、滋賀県、東京都)
関係会社	国内3社（熊本県2社、東京都） 海外9社（アメリカ、メキシコ、ドイツ、シンガポール、タイ、マレーシア、中国2社・台湾）

I . 2024年度 第3四半期業績（連結）

業績概要

※第3四半期累計

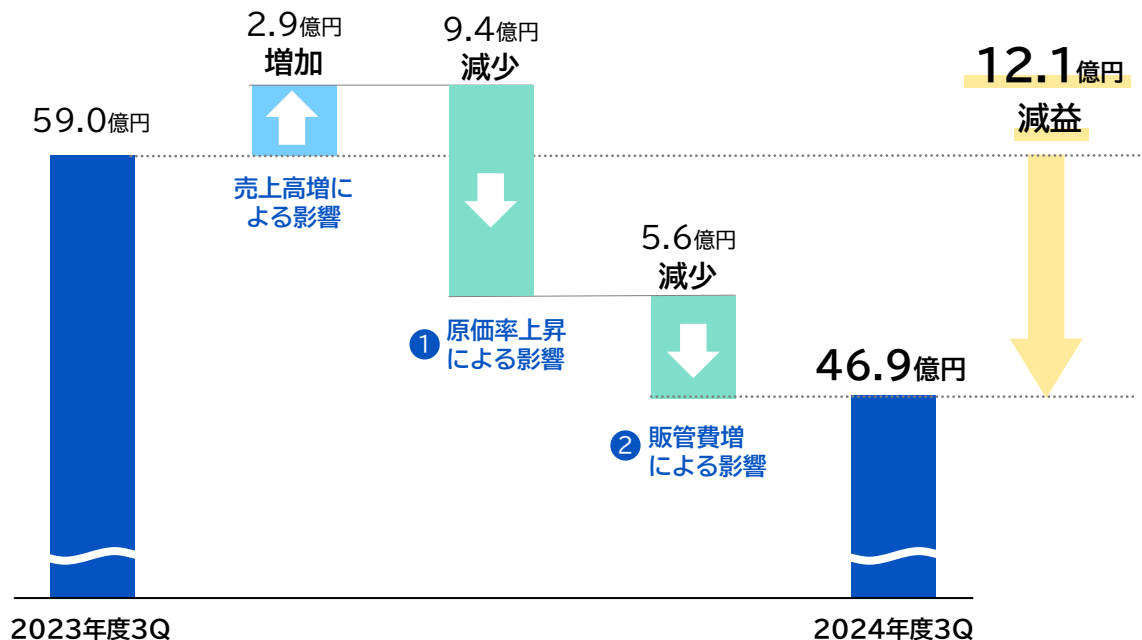
- **受注高** 対前年同期で減。半導体関連は回復基調にあり前年を上回るも、その他自動省力機器における減少をカバーできず
- **売上高** 対前年同期で増。自動車関連を中心に受注済案件の生産が進捗
- **営業利益** 対前年同期で減。従来4Qに計上していた一部費用を前倒しで計上したことに加え、固定費の増加等により減益

（単位：百万円）

	2023年度3Q	2024年度3Q	対前年同期	
	実績	実績	増減額	増減率
受注高	61,984	58,958	▲3,025	▲4.9%
売上高	61,008	62,323	1,314	2.2%
営業利益 (利益率)	5,903 (9.7%)	4,693 (7.5%)	▲1,210	▲20.5%
経常利益	6,103	4,502	▲1,601	▲26.2%
親会社株主に 帰属する当期純利益	4,647	2,939	▲1,707	▲36.7%
受注残高	62,980	62,040	▲939	▲1.5%

営業利益の増減要因分析

- 営業利益は対前年同期で12.1億円減
 - 主な増加要因：売上高の増加
 - 主な減少要因：人件費の増加等による原価率上昇や販管費の増加



① 原価率上昇による影響

原価率 77.3% ⇒ 78.8%

原価率上昇の主な要因

- ・従来4Qに計上していた賞与引当金の一部前倒し計上（人件費）
- ・賃上げ・人員増による人件費増
- ・減価償却費増
- ・物価上昇による影響

② 販管費増による影響

販管費増の主な要因

- ・従来4Qに計上していた賞与引当金の一部前倒し計上（人件費）
- ・賃上げ・人員増による人件費増

セグメント別業績まとめ

(単位：百万円)		2023年度3Q	2024年度3Q	増減	増減率
受注高	合計	61,984	58,958	▲3,025	▲4.9%
	自動車	28,426	27,863	▲562	▲2.0%
	半導体	19,675	21,695	2,019	10.3%
	その他自動省力機器	12,081	7,741	▲4,339	▲35.9%
	その他	1,800	1,658	▲142	▲7.9%
売上高	合計	61,008	62,323	1,314	2.2%
	自動車	26,842	30,061	3,218	12.0%
	半導体	20,126	21,409	1,282	6.4%
	その他自動省力機器	12,174	9,319	▲2,854	▲23.4%
	その他	1,864	1,531	▲332	▲17.8%
営業利益	合計	5,903	4,693	▲1,210	▲20.5%
	自動車	1,917	2,688	770	40.2%
	半導体	3,652	2,544	▲1,108	▲30.3%
	その他自動省力機器	375	▲525	▲900	-
	その他（消去含む）	▲41	▲14	27	-
受注残高	合計	62,980	62,040	▲939	▲1.5%
	自動車	33,225	36,952	3,726	11.2%
	半導体	21,302	19,756	▲1,546	▲7.3%
	その他自動省力機器	7,927	4,716	▲3,210	▲40.5%
	その他	524	614	90	17.2%

セグメント別業績：自動車関連

- **受注高** 前年同期並み。EV向けバッテリー充放電関連設備やEDU組立ラインの大型案件を受注し、高水準を維持
- **売上高** 対前年同期で増。前期受注済のEV関連案件（主にEDUやバッテリー関連等）および内燃機関案件の生産が進捗
- **営業利益** 対前年同期で増。一部費用の計上時期変更（4Q→2Q・3Q）が営業利益を押し下げても、高い増収効果に加え、個別案件における価格転嫁の推進や習熟度の向上により収益性が改善し増益

（単位：百万円）

		2023年度3Q		2024年度3Q		対前年同期	
		実績	セグメント内構成比	実績	セグメント内構成比	増減額	増減率
受注高		28,426	-	27,863	-	▲562	▲2.0%
	EV	21,481	75.6%	19,814	71.1%	▲1,666	▲7.8%
	その他	6,945	24.4%	8,049	28.9%	1,104	15.9%
売上高		26,842	-	30,061	-	3,218	12.0%
	EV	20,481	76.3%	19,774	65.8%	▲706	▲3.4%
	その他	6,361	23.7%	10,286	34.2%	3,925	61.7%
受注残高		33,225	-	36,952	-	3,726	11.2%
営業利益		1,917	-	2,688	-	770	40.2%
営業利益率		7.1%	-	8.9%	-	-	-

セグメント別業績：半導体関連

- **受注高** 対前年同期で増。2Q以降ウェーハ搬送関連の受注が回復基調
- **売上高** 対前年同期で増。受注増を受け、ウェーハ搬送関連の生産が進捗
- **営業利益** 対前年同期で減。高利益率案件が減少したことに加え、一部費用の計上時期変更（4Q→2Q・3Q）が営業利益を押し下げ
また、部材価格の高騰および価格転嫁の遅れにより原価率が悪化

（単位：百万円）

		2023年度3Q		2024年度3Q		対前年同期	
		実績	セグメント内構成比	実績	セグメント内構成比	増減額	増減率
受注高		19,675	-	21,695	-	2,019	10.3%
	ウェーハ搬送	13,054	66.3%	17,672	81.5%	4,618	35.4%
	その他	6,621	33.7%	4,022	18.5%	▲2,598	▲39.2%
売上高		20,126	-	21,409	-	1,282	6.4%
	ウェーハ搬送	13,842	68.8%	15,002	70.1%	1,159	8.4%
	その他	6,284	31.2%	6,407	29.9%	122	2.0%
受注残高		21,302	-	19,756	-	▲1,546	▲7.3%
営業利益		3,652	-	2,544	-	▲1,108	▲30.3%
営業利益率		18.1%	-	11.9%	-	-	-

セグメント別業績：その他自動省力機器

- **受 注 高** 対前年同期で減。有機EL・家電関連の受注に支えられた前年同期を下回る。顧客の設備投資の延期等も影響
- **売 上 高** 対前年同期で減。受注済案件の生産が進捗するも、顧客の投資延期等が影響し低調に推移
- **営業利益** 対前年同期で減。一部案件の原価率が悪化したことに加え、一部費用の計上時期変更（4Q→2Q・3Q）が営業利益を押し下げ

（単位：百万円）

	2023年度3Q		2024年度3Q		対前年同期	
	実 績	セグメント内構成比	実 績	セグメント内構成比	増 減 額	増 減 率
受注高	12,081	-	7,741	-	▲4,339	▲35.9%
売上高	12,174	-	9,319	-	▲2,854	▲23.4%
受注残高	7,927	-	4,716	-	▲3,210	▲40.5%
営業利益	375	-	▲525	-	▲900	-
営業利益率	3.1%	-	▲5.6%	-	-	-

貸借対照表

（単位：百万円）

資産	2023年度	2024年度3Q	増減
流動資産	88,554	89,017	463
現金及び預金	10,652	9,629	▲1,023
売上債権等	59,504	61,527	2,023
棚卸資産	14,264	15,356	1,091
その他	4,131	2,503	▲1,627
固定資産	42,233	42,178	▲55
有形固定資産	27,437	26,605	▲832
無形固定資産	904	1,058	154
投資その他の資産	13,891	14,514	623
資産合計	130,787	131,196	408

負債	2023年度	2024年度3Q	増減
流動負債	49,864	48,098	▲1,765
固定負債	15,621	16,857	1,236
負債合計	65,485	64,956	▲529

純資産			
純資産合計	65,302	66,240	937

主な増減要因

- ・現金及び預金：工場増設費や買掛金の支払が進み減少
- ・流動負債：工場増設費や賞与の支払により未払金・未払費用が減少
生産が進捗したことにより契約負債が減少
- ・固定負債：大型案件や長納期案件増により長期借入金が増加

Ⅱ. 2024年度 通期業績予想（連結）

通期業績予想

- 2024年度（2025年3月期）の通期業績予想を修正いたします

（単位：百万円）

	2023年度	2024年度	2024年度	対前期
	実績	通期予想（修正前）	通期予想（修正後）	増減率
売上高	82,839	100,000	89,000	7.4%
自動車関連	36,984	50,000	44,000	19.0%
半導体関連	27,390	29,000	30,000	9.5%
その他自動省力機器	16,083	19,000	13,000	▲19.2%
その他	2,381	2,000	2,000	▲16.0%
営業利益（率）	6,047(7.3%)	7,500(7.5%)	6,400(7.2%)	5.8%
経常利益（率）	6,259(7.6%)	7,300(7.3%)	6,200(7.0%)	▲0.9%
親会社株主に帰属する 当期純利益（率）	4,344(5.2%)	4,700(4.7%)	4,200(4.7%)	▲3.3%

通期業績予想のポイント

- 売上高を 1,000億円 → 890億円、営業利益を75億円 → 64億円 に下方修正
- 売上高・営業利益ともに前年度は上回る見通し

① 売上高 1,000億円 → 890億円

- ・顧客の設備投資計画の遅延等により一部案件の売上計上時期が来期にスライド
- ・その他自動省力機器分野において当期受注・当期売上を見込んでいたいくつかの案件を計画から除外。他案件による挽回を図るも、期初計画は下回る

② 営業利益 75億円 → 64億円

- ・売上高が期初予想を下回り、固定費の増加に対して十分な売上を確保できず利益率が低下
- ・一部案件の原価率が悪化

Ⅲ. 株主還元等について

1株当たり配当金・配当性向 推移および予想

(単位：円)

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度 予想
1株当たり配当金	40.00	65.00	65.00	90.00	100.00	120.00
配当性向 (%)	23.8	16.6	25.2	21.9	23.9	29.6

※配当性向は連結ベースです。

<配当に対する考え方>

当社は、株主に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、財務体質の強化を図りつつ、連結業績や今後の事業展開などを勘案しながら、連結配当性向20%以上を概ねの目安とし、安定的・継続的に行うよう努めております。

今期の配当につきましては、期末配当として120円を予想しております。

なお、今後の配当に対する考え方につきましては、株主還元策も含めた資本政策の中で検討を進めてまいります。

自己株式の取得

- 資本効率の向上および株主への利益還元ならびに経営環境の変化などに応じた資本政策の柔軟性・機動性の確保を図り、自己株式の取得を行いました

重要事項	内容
取得した株式の種類	当社普通株式
取得した株式の総数	190,200株
株式の取得価額の総額	999,898,000円
取得期間	2024年11月11日から2024年12月5日（約定ベース）

（ご参考）2024年12月末時点の自己株式の保有状況

- ・発行済株式総数（自己株式を含む） 10,756,090株
- ・自己株式数（信託口含む） 559,293株

株式分割

- 株式の流動性の向上および投資家層のさらなる拡大を図るため、株式分割を実施いたします

分割の方法

2025年3月31日（月曜日）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の保有する普通株式を1株につき3株の割合をもって分割いたします

分割により増加する株式数

発行済株式総数	分割前	10,756,090株	▶	分割後	32,268,270株（3分割）
発行可能株式総数	分割前	37,000,000株	▶	分割後	111,000,000株

分割の日程

基準公告日（予定）	2025年3月14日（金曜日）
基準日	2025年3月31日（月曜日）
効力発生日	2025年4月 1日（火曜日）

※2025年3月31日を基準日とする期末配当金は、株式分割前の株式を対象として支払われます

※2025年3月31日時点の株主様に対する株主優待は、現行制度に基づき従来通りの内容で実施いたします。2026年3月期以降の株主優待制度の内容につきましては、決定次第お知らせいたします

IV. トピックス

SEMICON Japan 2024 出展について

- 当社は、半導体関連製品をPRし、販路拡大・売上拡大に繋げるべく、SEMICON Japan 2024に出展いたしました

出展期間	2024年12月11日(水)～13日(金)	出展製品	PLP基板搬送ロボット・ロードポート、DDロボット等
会場	東京ビッグサイト	当社ブースへの来場者	約 2,000名



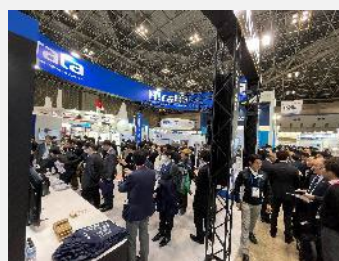
当社出展ブース



PLP基板搬送ロボット



PLP対応ロードポート

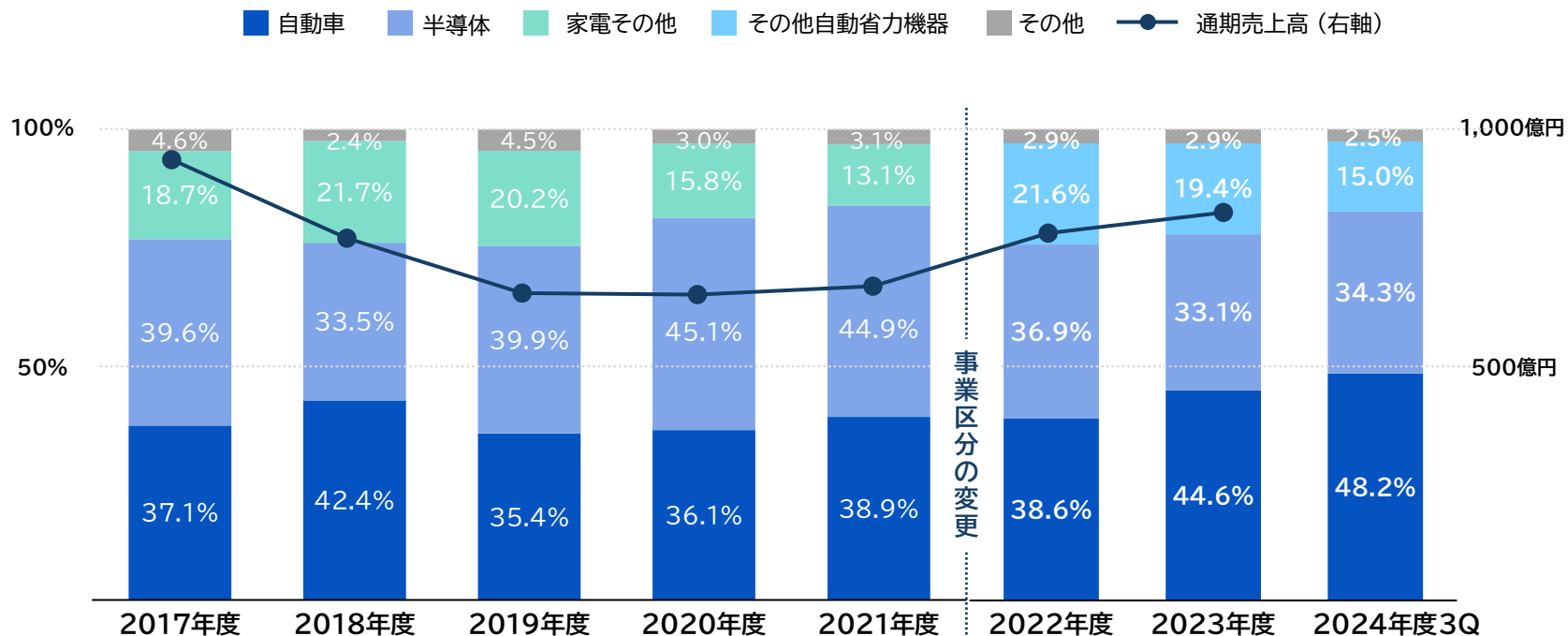
ダイレクトドライブ
ウェーハ大気搬送ロボット電動ベルトコンベヤ／
ロボット機構異常検知AI(パネル展示)

多数のご来場者様

- 生成AIの需要増等を背景に、後工程におけるPLP (Panel Level Packaging)技術の重要度が高まる中、ウェーハ搬送製品で培った気流制御技術等を継承した製品を出展
- 併せて、ウェーハ基板用ダイレクトドライブロボット、FOUP搬送用電動コンベヤ等を出展
- ブースには、業界関係者のみならず機関投資家の方、個人投資家の方もご来場いただき、熱心に説明を聞いていただきました

V. 参考資料

セグメント別 売上高・構成比推移

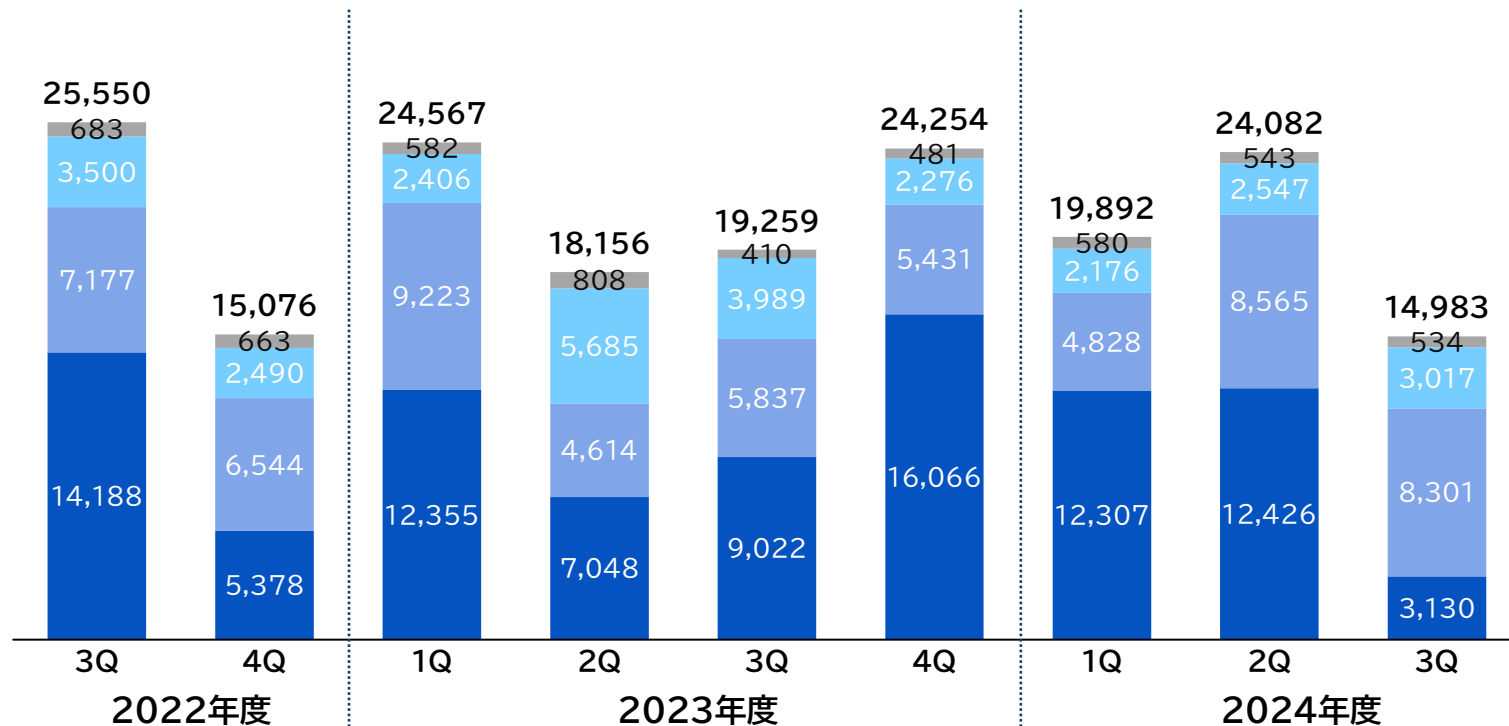


※2022年度より、事業区分の変更を行っております。

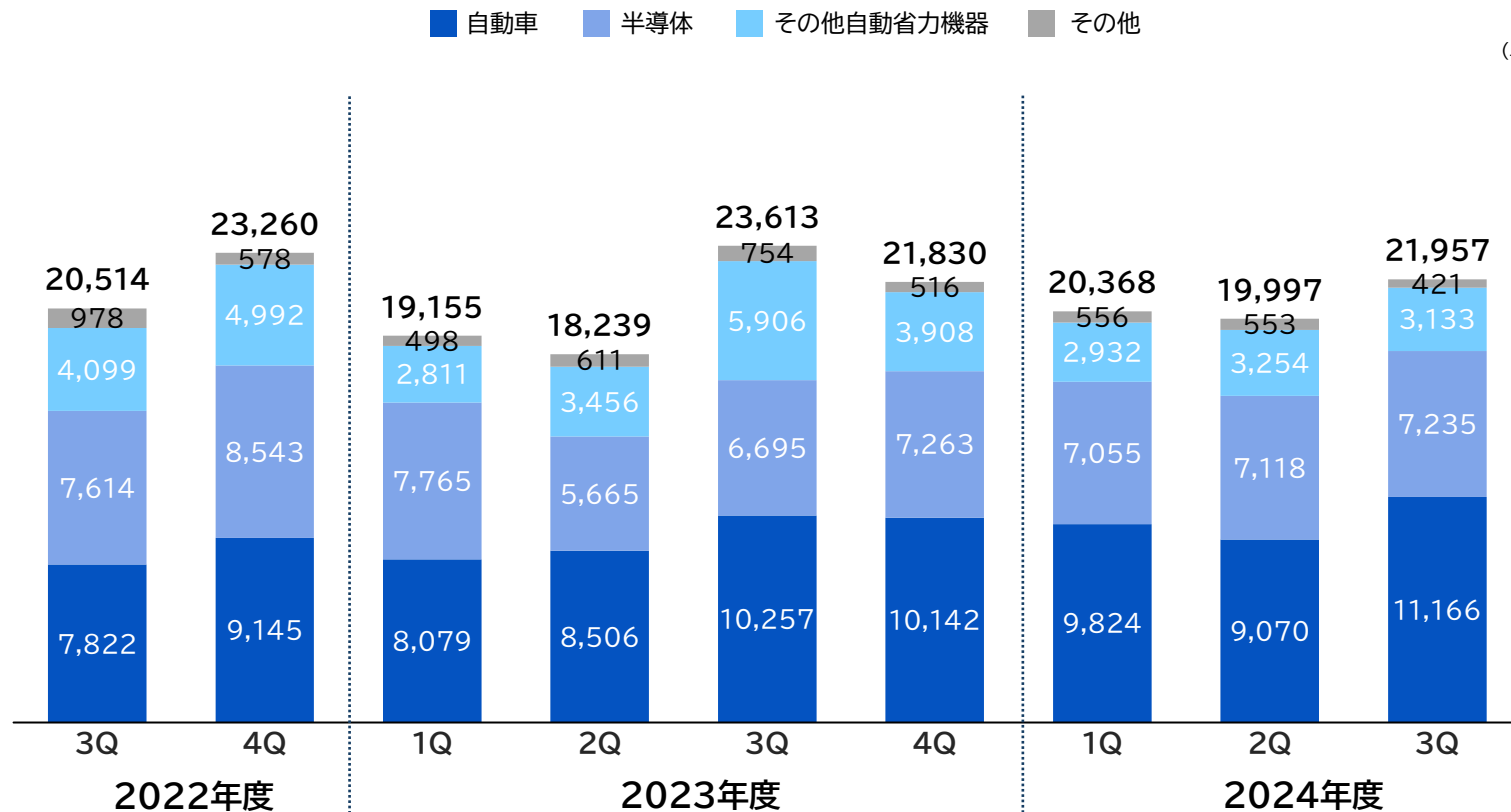
セグメント別 四半期推移【受注高】

自動車 半導体 その他自動車省力機器 その他

(単位：百万円)

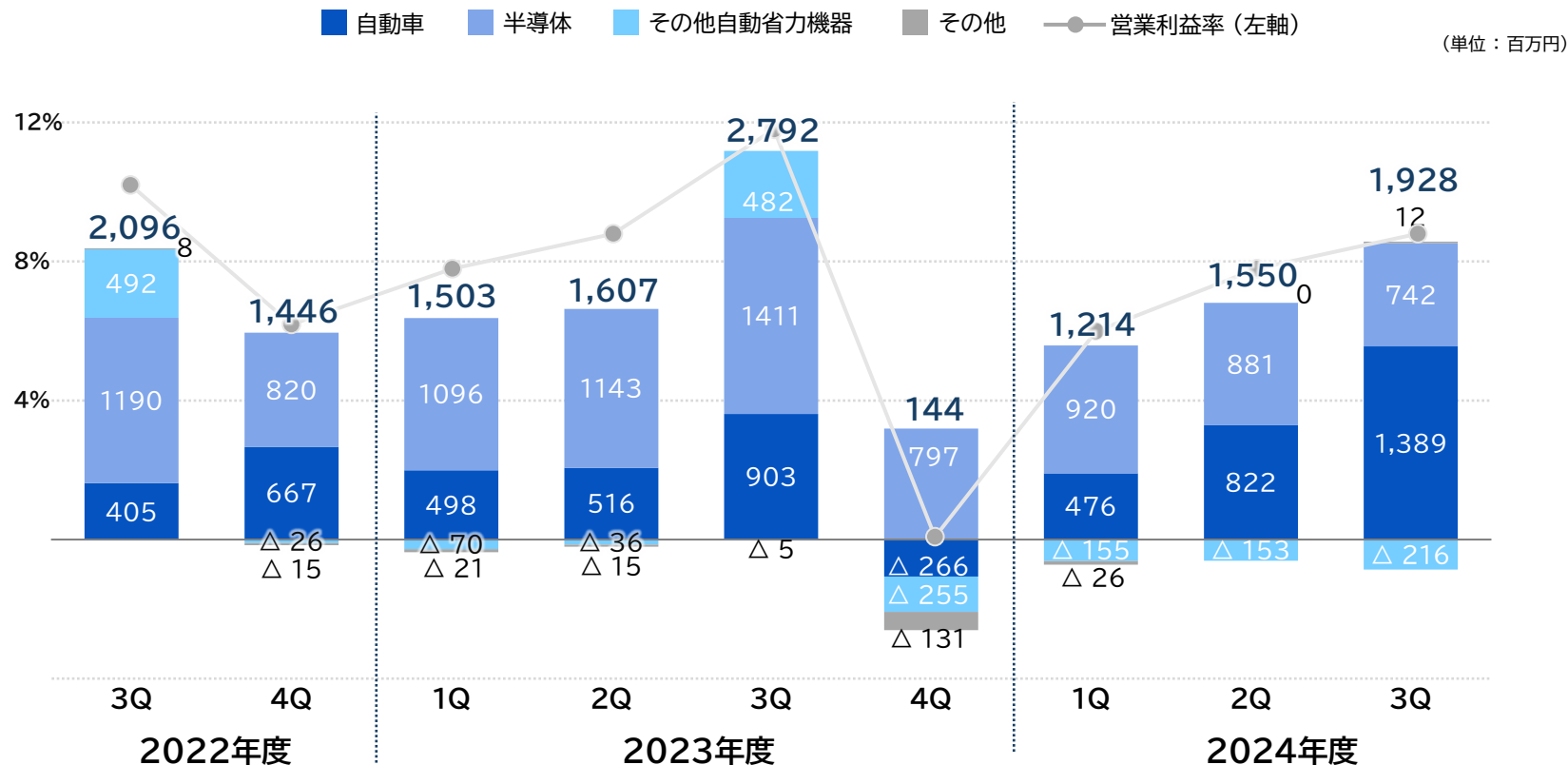


セグメント別 四半期推移【売上高】

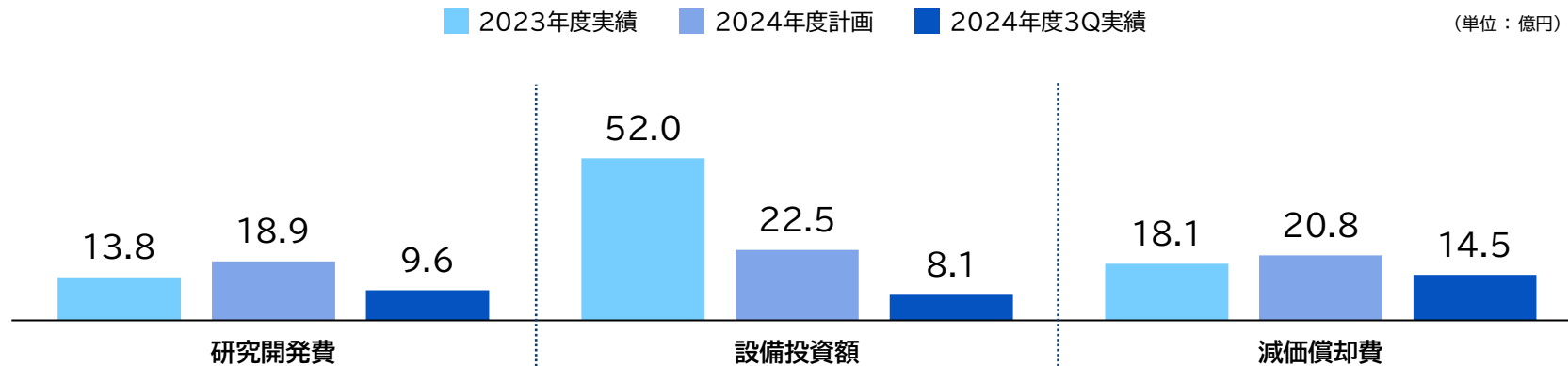


セグメント別 四半期推移【営業利益】

※その他に消去含む



研究開発費・設備投資額・減価償却費

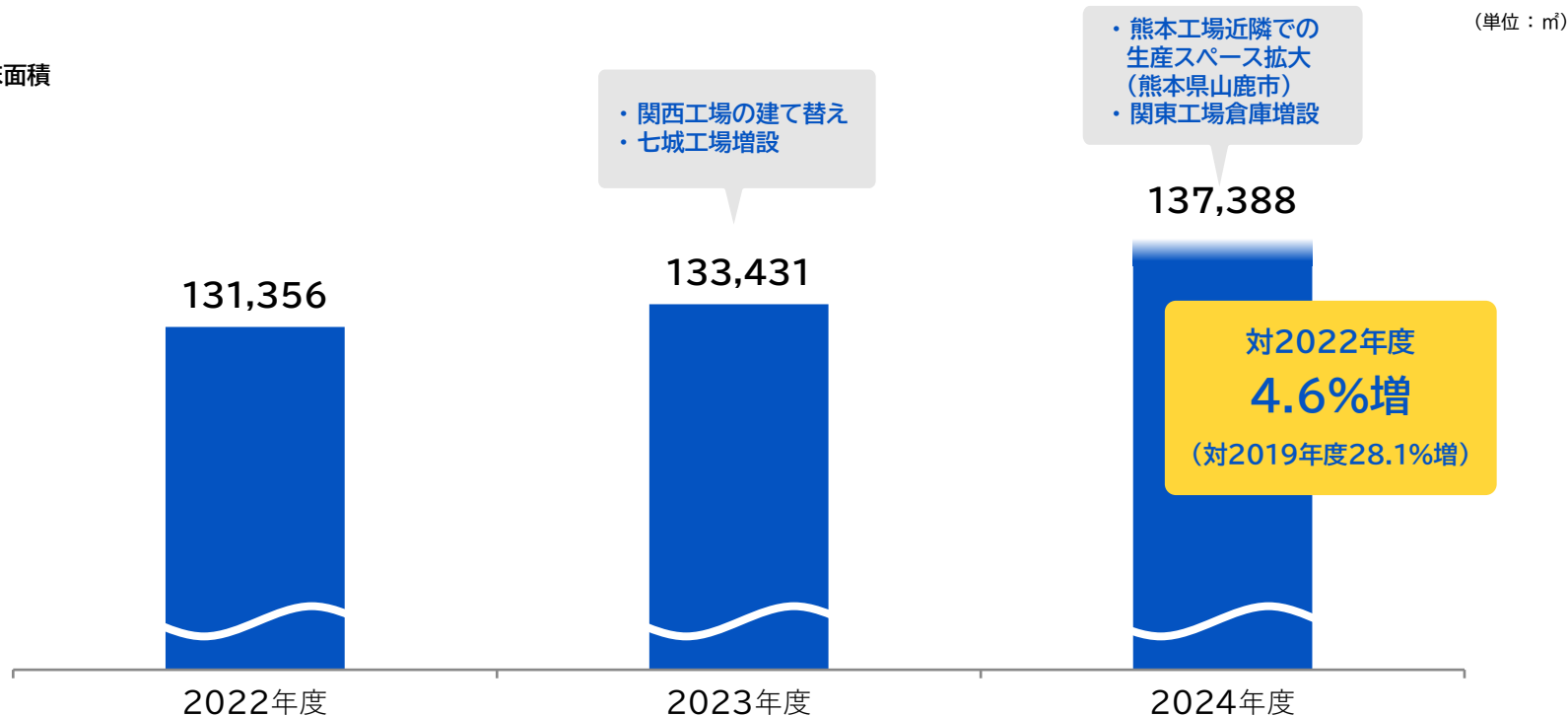


主な内容		2024年度 計画	2024年度 3Q実績
研究開発費	- 既存事業における次世代製品開発 - 植物遺伝資源関連 など	約 18.9 億円	約 9.6 億円
設備投資	- 工場の建替・増築 - 情報システム関連 など	約 22.5 億円	約 8.1 億円
減価償却費	工場建替や機材の減価償却 など	約 20.8 億円	約 14.5 億円

生産スペース(単体・期末時点)

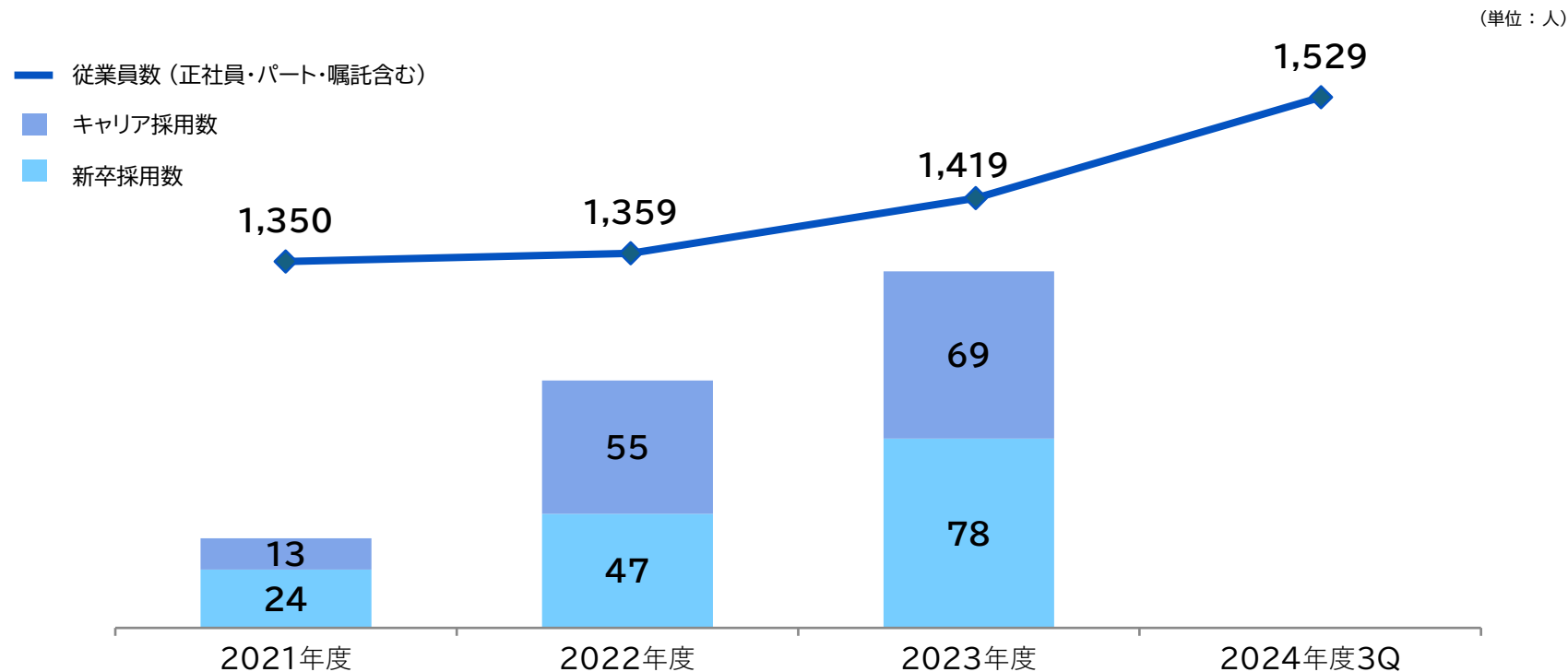
- 生産能力向上に向けた生産スペースの継続的な拡大に取り組んでいる
- 2024年度も熊本市に隣接する山鹿市に生産スペースを確保

■ 延床面積



採用数・従業員数（単体・期末時点）

- 事業拡大を見据え、継続的な人材確保を図る
- 賃金改善、働き方改革、福利厚生、教育訓練の充実等で人材のリテンションに取り組む



想定される主な外部環境起因の機会／リスクと対応策

想定される 主な外部環境	想定する機会／リスク	主な対応策
為替変動の影響	リスク - 海外競合との相対的な価格競争力の増減 - 海外調達品の実質購入価格の増減	- 海外案件の積極的な受注拡大 - 海外での現地生産の推進
米国新政権の動向	リスク - EV市場動向を懸念した投資控え - 関税政策による影響	- 顧客との緊密な情報交換による設備投資動向の把握 - 対応領域拡大による新規顧客・案件確保 - 主力事業の分散とリソース配分の適正化
新タイプバッテリーの量産化	機会 - 技術開発と量産対応による商機拡大 リスク - 開発要素負担による収益性悪化	- 顧客の研究開発段階から参画し、顧客要求に即した製品の開発・提案 - 外部調達による開発費削減
生成AI市場の動向	機会 - ウェーハ搬送・PLPなどの半導体関連装置の需要増 リスク - 生産能力・人的リソース不足による受注機会の損失	- 既存顧客からの継続的な引合い獲得に向けたQCD向上 - 半導体分野へのリソース投入 ＝受注拡大を見据えた人材・生産能力への先行投資
熊本・九州への半導体 関連産業の集積	機会 - 半導体関連の需要増 リスク - 人材獲得競争の激化	- 既存顧客からの継続的な引合い獲得に向けたQCD向上 - 半導体分野へのリソース投入 ＝受注拡大を見据えた人材・生産能力への先行投資 - 積極的な人材採用 - 社会動向も踏まえた賃金改定やリテンションの実施

開示情報：大型案件の受注

2023年度以降に開示した大型受注案件

事業部門	開示日		設備概要	金額
自動車関連	2023年	6月	EV向けドライブユニット（EDU）組立設備	80億円超
	2024年	1月	EV向けバッテリー充放電関連設備	40億円超
		2月	内燃機関向けエンジン組立設備	約130億円
		5月	EV向けバッテリー充放電関連設備	約25億円
		8月	EV向けバッテリー充放電関連設備	約56億円
		8月	EV向けドライブユニット（EDU）組立設備	約87億円

- ・バッテリー充放電関連設備は2022年度より本格的な受注を開始し、受注実績は累計で150億円超
- ・大規模案件への対応力ならびにこれまでの納入実績等が評価され、継続して受注獲得

ESG経営の取り組み強化

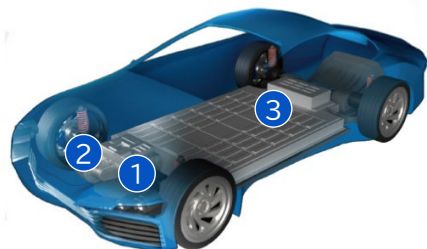
2022年	10月	「人権方針」策定、「調達基本方針」改定	
2023年	4月	サステナビリティ推進委員会発足 HPに「サステナビリティページ」を新設し、ESGの情報発信を強化	 WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT
	9月	「国連グローバル・コンパクト」署名	
	10月	人権デュー・ディリジェンス導入	
	11月	経団連「企業行動憲章」への賛同表明	
2024年	1月	「Hirataグループ行動規範」制定 サステナビリティ推進委員会に「人権尊重ワーキンググループ」設置	 FTSE Blossom Japan Index  FTSE Blossom Japan Sector Relative Index
	6月	「FTSE Blossom Japan Index」 「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に選定	
	11月	「経団連生物多様性宣言イニシアチブ」への参画	

事業概要：自動車関連の主要製品

- EV関連を中心に、北米自動車メーカー（ビッグスリー）・北米新興EVメーカー・国内電子部品メーカーから継続受注

EV関連の主力・拡大分野

当社が手掛ける生産設備



※完成製品イメージ

主要な地域・顧客・優位性

EDU組立設備

北米

顧客 ・ 北米自動車メーカー（ビッグスリー）
・ 北米新興EVメーカー

IGBT・インバーター組立設備

日本

顧客 国内車載用電子部品メーカー

バッテリー関連組立設備（充放電工程）

日本

顧客 国内バッテリーメーカー

① EDU組立設備 主力分野

EDU (Electric Drive Unit) と呼ばれる車載用のモーターとギアボックスを組み合わせた、EVの駆動用部品の組立設備を製造



② IGBT・インバーター組立設備 主力分野

IGBTやインバーターといった、EVやトランスミッション車に搭載される車載用電子部品の組立設備を製造



③ バッテリー関連組立設備（セル充放電工程） 拡大分野

バッテリーのセル工程の一部である充放電工程の搬送設備を製造



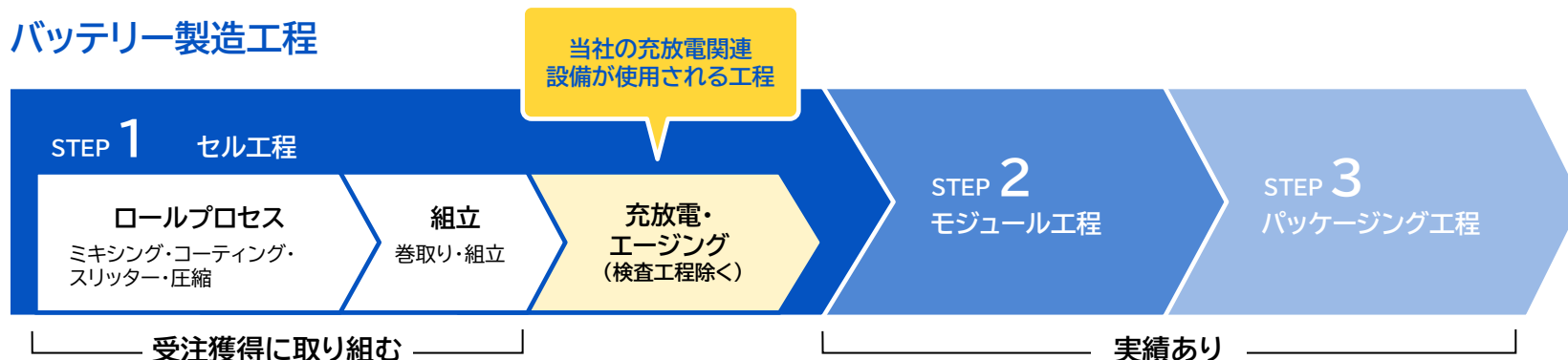
当社の競争優位性

- ・ 最長で総延長1kmを超える大型設備を自社のみで手掛ける技術力
- ・ 顧客の生産ラインを一度自社工場内で構築し、生産能力・品質を検証した上で現地据え付け
- ・ 開発から生産・保守までの一貫体制
- ・ 顧客要求に応えるエンジニアリング力

事業概要：充放電関連設備

- セル製造の最終工程である「充放電・エージング」を担う充放電関連設備
- 搬送・ストッカー技術を生かしたシステム化に当社優位性あり

バッテリー製造工程



当社の製品：充放電関連設備

- 組み立てられたセル（電池）に充放電を繰り返すことでセルを活性化させる（バッテリーとしての機能をもたせる）工程
- 当社で製造した搬送ラインや自動倉庫に、外部より調達した充放電機を組み合わせ、システムとして顧客に納品
当社の搬送・ストッカー技術が差別化要因

搬送システム

工程間の最適搬送を行う

エージング用 倉庫システム

高温環境でのテストや自動倉庫に長期間収納放置し、一定期間後のセル電圧をパフォーマンス測定

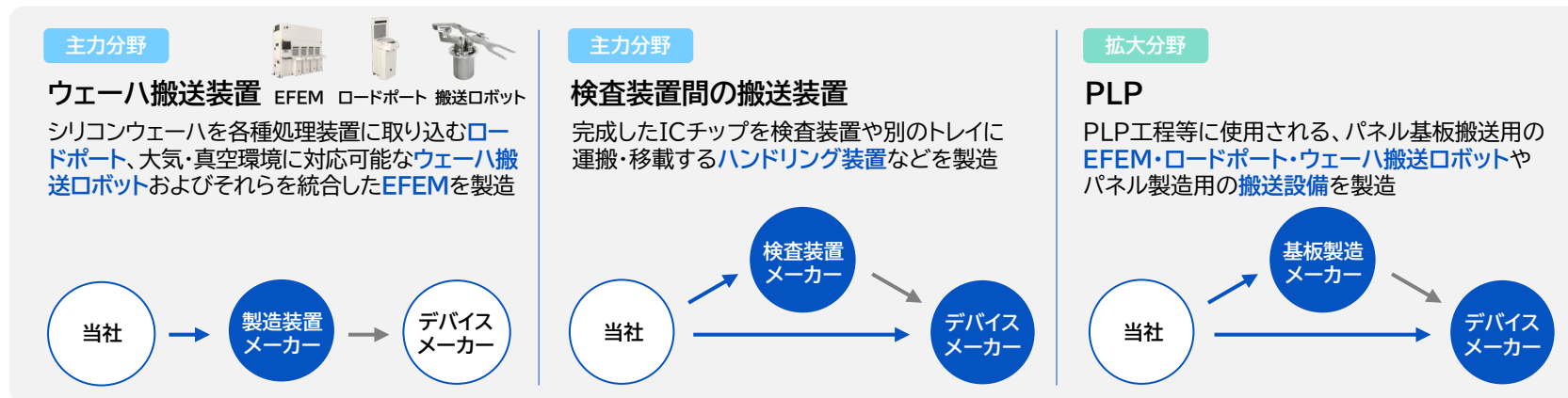
充放電用 倉庫システム

満充電と放電を数回繰り返す工程。充電容量、充電速度、繰り返し回数等によって数時間を要する

事業概要：半導体関連の主要製品

- 国内製造装置メーカー向けのウェーハ搬送装置や検査装置間のハンドリング装置を中心に継続受注

半導体関連の主力・拡大分野



主要な地域・顧客・優位性

ウェーハ搬送装置 日本 顧客 国内製造装置メーカー	検査装置間の搬送装置 北米・日本 顧客 ・北米デバイスメーカー ・国内検査装置メーカー	PLP 北米・欧州・日本 顧客 ・北米デバイスメーカー ・国内/欧州基板製造メーカー
---	---	--

当社の競争優位性

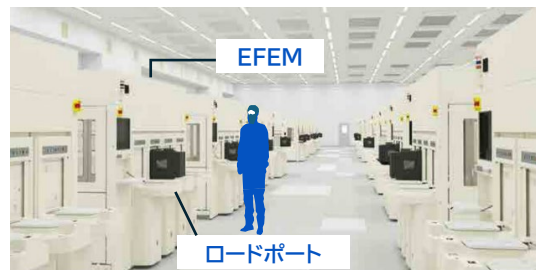
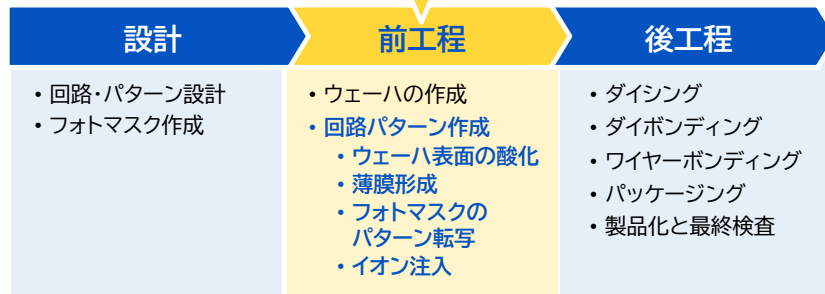
- 豊富なコンポーネントのラインナップ
- 顧客の要望に合わせたカスタマイズ・最適化に必要な知見・技術
- 開発から生産・保守までの一貫体制
- 顧客要求に応えるエンジニアリング力

事業概要：ウェーハ搬送装置

- 主に半導体製造の前工程でウェーハを各種処理装置に取り込むロードポート、ウェーハの受け渡しを行うウェーハ搬送ロボットおよびそれらを統合したEFEM（イーフェム）を設計・製造

半導体製造工程

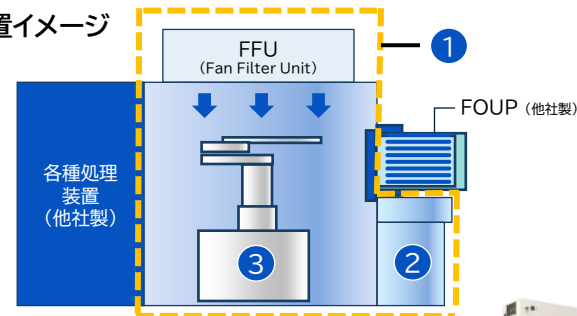
当社ウェーハ搬送装置が
主に使用される工程



- 各種処理装置ごとにEFEM・ロードポートが設置される
- 1つのラインで複数のEFEM・ロードポートが用いられる

当社の主要製品

当社製品設置イメージ



- EFEM (Equipment Front End Module)**
処理装置ごとに置かれ、内部にウェーハ搬送ロボット、前面にロードポートが設置される
- ロードポート**
FOUP※の裏面の蓋の開閉を行う。EFEMを構成する装置であるが、単品での販売も行っている
- ウェーハ搬送ロボット**
FOUPからウェーハを取り出し、処理装置へ搬送。処理後、再びFOUPに収納する。EFEMを構成する装置であるが、単品での販売も行っている

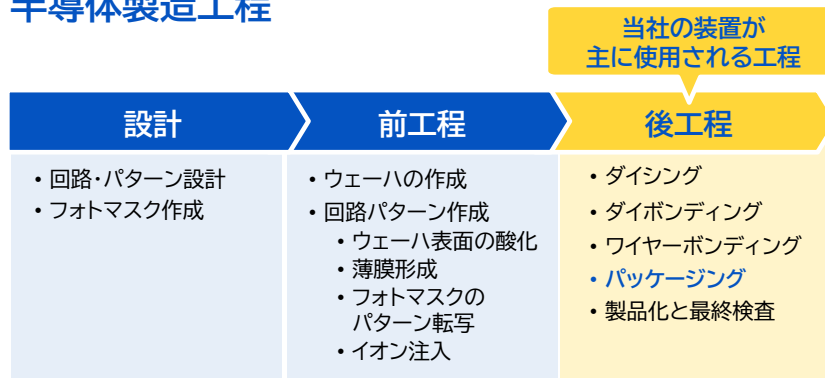
※FOUP：複数枚のウェーハを収納し工程間を移動するウェーハの容器



事業概要：PLP

- 先端パッケージング技術として拡大が期待される「PLP」で用いられる搬送装置を設計・製造

半導体製造工程



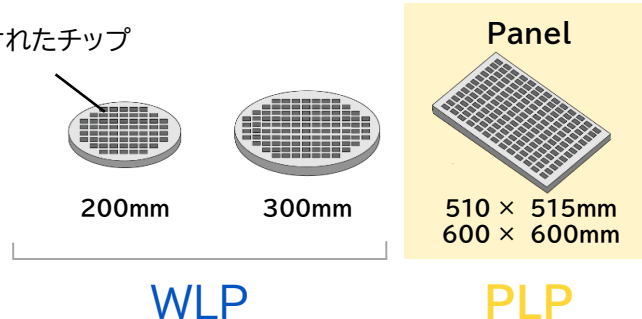
PLP (Panel Level Packaging) とは

- パッケージング工程で、回路形成後に個々に切り分けた多数のチップを、薄型で四角形のパネル基板上に再配列し、一括成形するパッケージング技術
- PLPでは一般的に510×515mm角など、ウェーハの標準規格である300mmより大きいパネル基板が用いられる
- パネル基板には、プリント基板や液晶パネル製造用のガラス基板・銅板を使用

パッケージング工程の違い

従来のパッケージ	ウェーハ上に回路を形成し、チップを細かく切り分けたのち、個々に基板に接着・封止して製品化
WLP (Wafer Level Package)	チップを個々に切り分けた後、 良品チップのみをウェーハ上に再配列 し、チップがウェーハ上にある状態で基板に接着・封止し、個々に切り分ける
PLP (Panel Level Package)	チップを個々に切り分けた後、 良品チップのみを四角形のパネル上に再配列 し、チップが パネル上にある状態 で基板に接着・封止し、個々に切り分ける

再配列されたチップ



事業概要：その他自動省力機器

- 有機ELの蒸着装置や家電メーカー向けの組立設備、医療理化学機器などさまざまな産業分野向け製品を製造

その他自動省力機器の主力・新規分野

主力分野

医療理化学機器

検体検査用の装置（病理組織標本作製装置や全自動連続薄切装置）を製造

主力分野

家電メーカー向け組立設備

高性能家電に組み込まれるモーターの組立設備をはじめあらゆる設備・装置を製造

有機EL用蒸着装置

有機ELパネル用の真空蒸着装置の製造を受託

収益化に向けた新規分野

超音波ガイド下 集束超音波治療装置

- ・ すい臓がんを対象にした集束超音波治療装置をソニア・セラピューティクス社（本社：東京都新宿区、以下ソニア社）と共同開発中
- ・ ソニア社の集束超音波技術と当社ロボット技術を融合させ、患者にやさしい非侵襲的ながん治療を目指す
- ・ 人での臨床試験がスタートし、次なる量産用装置の開発に着手した

主要な地域・顧客・優位性

医療・理化学機器

日本

顧客 国内医療専門メーカー

家電メーカー向け 組立設備

アジア

顧客 アジア家電製造メーカー

有機EL用蒸着装置

日本

顧客 国内製造装置メーカー

当社の競争優位性

- ・ さまざまな分野の生産設備・装置に携わってきた豊富な知見とノウハウ
- ・ 開発から生産・保守までの一貫体制
- ・ 顧客要求に応えるエンジニアリング力

事業概要：超音波ガイド下集束超音波治療装置

- 医療・理化学機器分野での検体検査自動化の経験とロボット技術を応用し「治療」領域へ進出

当社既存事業 平田機工バイオ機器部

「検体検査」の自動化技術



医療機器20年以上の実績
(クラスⅠ：一般医療機器)

新規パートナー ソニア社

臨床・治験・集束超音波技術

東京女子医科大学、東北大学、東京医科大学
で10年以上掛けて築き上げてきた技術

当社既存技術 平田機工ロボット事業部

ロボット技術

産業用ロボットの実績



新分野への進出

ソニア社にて治験を実施
当社は製造体制を構築

がん治療装置 共同開発

販売開始・量産を目指す
(クラスⅢ：高度管理医療機器)

- 医療・理化学機器分野において、ソニア・セラピューティクス株式会社(以下ソニア社)と提携
- 治験(人での臨床試験)用のがん治療装置の共同開発を実施(切除不能のすい臓がんが対象)
- 皮膚切開や臓器の切除を伴わない低侵襲な治療のための装置を開発
- 複数の国内病院に納入し、ソニア社にて国内治験を実施中。当社は納入後のアフターサービスを実施中
- 今後は装置の安全性、ユーザビリティ(使用性)、デザインなどをブラッシュアップし、量産装置の開発、量産体制の構築を目指す
- 海外展開を計画しており、海外病院への早期納入および当社海外拠点でのアフターサービスを目指す

本資料のお取り扱い上のご注意

ご注意

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化などのさまざまな要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。